

“AI 팩토리, 차세대 데이터센터 될 것”… 韓 메모리 기업 부각

젠슨 황, 韓 기업 핵심 파트너 언급
차세대 AI 플랫폼 ‘베라 루빈’ 공개
AMD, 차세대 AI GPU로 도전장
슈퍼마이크로, AI 서버시스템 선배
LG전자, 냉각 솔루션 수혜 가능성



젠슨 황 엔비디아 최고경영자(CEO)가 16일(현지 시간) 미 캘리포니아 주 새너제이 SAP 센터에서 열린 엔비디아의 인공지능(AI) 콘퍼런스 ‘GTC 2026’에서 기조연설하고 있다. /AP·뉴시스



젠슨 황 엔비디아 CEO가 GTC 2026 삼성전자를 방문해 기념촬영하고 있다. 왼쪽부터 황상준 삼성전자 메모리개발담당 부사장, 황 CEO, 한진만 삼성전자 파운드리 사업부장 사장. /삼성전자

세계 최대 인공지능(AI) 기술 행사인 엔비디아 ‘GTC 2026’에서 차세대 AI 반도체와 데이터센터 전략이 공개되며 AI 산업 경쟁이 칩 중심에서 데이터센터 인프라 중심으로 재편되고 있음을 보여줬다. 젠슨 황 엔비디아 최고경영자(CEO)는 삼성전자와 SK하이닉스를 AI 반도체 생태계의 핵심 파트너로 언급하며 감사의 뜻을 나타냈다. 행사 기간 중에는 최태원 SK그룹 회장과 만나 협력 관계를 재확인하며 AI 반도체 공급망에서 한국 메모리 기업의 중요성을 부각했다. 17일 업계에 따르면 16일(현지시간) 미국 캘리포니아 새너제이에서 열린 GTC에서는 차세대 AI 반도체와 함께 데이터센터 인프라 전략이 공개됐다. 네트워크·스토리지·소프트웨어 등 인프라가

술이 함께 소개되며 인공지능(AI) 산업 경쟁이 반도체 단일 제품을 넘어 데이터센터 생태계 전반으로 확장되고 있음을 보여줬다. 이날 젠슨 황 CEO는 기조연설에서 “AI는 이제 단순한 기술을 넘어 산업 전반을 움직이는 인프라가 되고 있다”며 “AI 팩토리는 차세대 데이터센터가 될 것”이라고 말했다. 특히 황 CEO가 한국 메모리 기업을 핵심 파트너로 언급하면서 삼성전자와

SK하이닉스의 역할이 다시 부각됐다. AI 데이터센터용 GPU에는 고대역폭 메모리(HBM)가 필수적으로 탑재되는 만큼 글로벌 AI 반도체 공급망에서 한국 메모리 기업의 영향력이 커지고 있다는 평가다. 행사 기간 중 이뤘던 황 CEO와 최태원 SK그룹 회장의 회동도 주목을 받았다. 최 회장이 GTC 행사장을 직접 찾은 것은 이번이 처음이다. 양측은 AI 반도체 협력 방안을 논의했으며 업계에서는

HBM 공급 확대와 AI 인프라 협력 가능성 등을 점검한 것으로 보고 있다. 국내 기업들도 이번 행사에서 기술 경쟁력을 강조했다. 삼성전자는 차세대 HBM인 HBM4E를 공개하며 AI 메모리 경쟁력을 부각했고 SK하이닉스는 HBM4 등 차세대 AI 메모리를 전시했다. AI 반도체 경쟁도 이어졌다. AMD는 차세대 AI GPU를 공개하며 엔비디아와 경쟁에 나섰다. 슈퍼마이크로는 엔비디아 GPU 기반 AI 서버 시스템을 선보

였다. LG전자는 데이터센터 냉각 솔루션 사업을 앞세워 AI 인프라 시장 확대에 따른 수혜 가능성을 강조했다. 엔비디아는 이번 행사에서 차세대 AI 플랫폼 ‘베라 루빈(Vera Rubin)’을 공개하고 AI 데이터센터 구축 전략도 제시했다. 베라 루빈은 CPU와 GPU, 네트워크 칩 등을 결합한 플랫폼으로 대규모 AI 모델 학습과 추론을 동시에 지원하도록 설계됐다. 또 AI 추론 소프트웨어 ‘다이나모(Dynamo) 1.0’과 데이터센터 설계 모델 ‘베라 루빈 DSX AI 팩토리 레퍼런스 디자인’도 공개했다. 이는 대규모 AI 데이터센터를 구축하고 운영하기 위한 인프라 구조를 제시한 것이다. 업계 관계자는 “AI 서비스 확산으로 데이터센터 구축 경쟁이 본격화되면서 GPU뿐 아니라 메모리, 네트워크, 냉각 등 인프라 전반의 역할이 커지고 있다”며 “이 과정에서 HBM을 공급하는 한국 메모리 기업들의 영향력도 계속 확대될 것”이라고 말했다. /구남영 기자



koogija_tea@metroseoul.co.kr

삼성전자, ‘베라 루빈’ 겨냥 HBM4E 공개

‘HBM4 히어로 월’ 전시 꾸리고
종합반도체 기업 경쟁력 부각



삼성전자 HBM4 제품(위), 삼성전자 SOCAM M2 제품(아래). /삼성전자

삼성전자가 16일(현지시간) 미국 새너제이에서 열린 엔비디아 GTC 행사에 참가해 7세대 고대역폭메모리, HBM4E 기술을 선보였다. 아울러 엔비디아 AI 플랫폼 ‘베라 루빈’을 구현하는 메모리 토탈 솔루션 공급 역량을 앞세워 글로벌 AI 시장 공략에 나선다는 전략이다. 삼성전자는 이날부터 19일까지 열리는 엔비디아 개발자 행사 GTC(GPU Technology Conference)에서 차세대 ‘H

BM4E’ 칩과 AI 인프라용 메모리 솔루션을 선보였다고 밝혔다. 삼성전자는 이번 전시에서 ‘HBM4 히어로 월(Hero Wall)’을 별도로 꾸리고 HBM4부터 메모리,

로직 설계, 파운드리, 첨단 패키징까지 종합반도체 기업(IDM)으로서의 경쟁력을 집중 부각했다. 전시 공간을 ▲AI 팩토리(AI Factories, AI 데이터센터) ▲로컬 AI(LoCAL AI, 온디바이스 AI) ▲피지컬 AI(Physical AI) 세 개로 나눠 GDDR7(그래픽용 D램), LPDDR6(저전력 D램), PM9E1(솔리드스테이트 드라이브) 등 차세대 메모리 아키텍처도 함께 소개했다. 삼성전자는 HBM4E 실물 칩과 코어다이 웨이퍼를 처음 공개했다. HBM4E는 1c D램 공정과 파운드리 4나노 베이

스 다이 설계를 기반으로 개발 중이며 핀당 최대 16Gbps 속도와 4.0TB/s 대역폭을 지원할 예정이다. 이와 함께 차세대 패키징 기술인 HCB(Hybrid Copper Bonding) 기술도 함께 소개됐다. 이 기술은 기존 TCB(Thermal Compression Bonding) 대비 열 저항을 20% 이상 개선하고 16단 이상의 고적층 HBM 구현을 지원하는 기술이다. 삼성전자는 “종합반도체 기업(IDM)만의 토탈 솔루션을 통해 개발 효율을 강화해 고성능 HBM 시대에서도 성능과 품질을 압도하는 기술 선순환 구조를 구축할 계획”이라고 전했다. 삼성전자는 엔비디아 차세대 AI 플랫폼인 ‘베라 루빈(Vera Rubin)’을 겨냥한 메모리 솔루션도 선보였다.

삼성전자는 ‘엔비디아 갤러리’를 별도로 구성, ▲루빈 첨단 그래픽처리장치(GPU)용 HBM4 ▲베라 중앙처리장치(CPU)용 저전력 메모리 모듈 소켓2 ▲스토리지 PM1763을 베라 루빈 플랫폼과 함께 전시하며 양사의 협력을 강조했다. 특히 소켓2는 LPDDR 기반 서버용 메모리 모듈로 삼성전자는 품질 검증을 완료하고 업계 최초로 양산 출하를 최근 시작했다. 또 PCIe 6세대(Gen6) 기반 서버용 SSD PM1763은 베라 루빈 플랫폼의 주력 스토리지로 제시됐다. 삼성전자는 “차세대 HBM과 메모리 솔루션을 통해 AI 인프라 시장에서 기술 경쟁력을 강화해 나갈 것”이라고 말했다. /구남영 기자



현대차, 엔비디아와 자율주행 시대 앞장

드라이브 하이퍼리온 도입
AI 데이터 선순환 체계 구축도

준 설계구조인 ‘엔비디아 드라이브 하이퍼리온’을 도입하기로 했다. 하이퍼리온은 고성능 CPU·GPU와 센서, 카메라 등을 통합한 레퍼런스 아키텍처다. 현대차그룹은 이를 기반으로 자율주행 레벨 2부터 레벨 4까지 유연하게 확장 가능한 통합 설계구조를 자체 구축한다는 전략이다. 우선 품질·안전 철학에 기반해 SDV 차량을 개발 중인 현대차·기아는 엔비디아가 보유한 레벨 2 이상의 첨단 운전자 보조 시스템(ADAS)을 일부 차종에 선제 적용하고, 중장기적으로는 미국 합작법인 ‘모셔널’을 통해 레벨 4로봇택시의 기술 고도화를 본격화한다. ◆데이터 선순환 체계 구축…AI 내재화로 경쟁력 차별화 양사는 단순히 하드웨어 도입을 넘어 ‘AI 내재화’를 위한 협력도 강화된다. 현대차그룹은 엔비디아의 광범위한 데이터와 AI 기술을 활용해 영상·언어·행동

데이터를 단일 학습 파이프라인으로 통합한다. 이를 통해 고성능 AI가 실제로 데이터를 스스로 수집하고 학습하는 ‘데이터 선순환 체계’를 구축, 자율주행 소프트웨어의 품질과 안전성을 획기적으로 높일 계획이다. 김홍수 현대차그룹 GSO(글로벌전략조직) 담당(부사장)은 “이번 파트너십 확대는 안전하고 신뢰할 수 있는 자율주행 기술 구현의 중요한 모멘텀이 될 것”이라며 “레벨 2부터 로보택시 서비스까지 차별화된 경쟁력을 확보하겠다”고 강조했다. 리시 달 엔비디아 자동차 부문 부사장 역시 “현대차그룹의 엔지니어링 기술력과 엔비디아의 컴퓨팅·AI 기술 결합으로 지능형 자율주행 시스템을 구축하고 있다”며 지속적인 협력을 약속했다. 현대차그룹은 글로벌 테크 기업과의 전략적 협업과 자체 기술 개발을 병행하며, 미래 모빌리티 시장에서 글로벌 대응력을 다각도로 강화해 나갈 방침이다. /양성운 기자 ysw@

HBM 중심 글로벌 AI 생태계 협력 굳히기

▶ 1면 ‘최태원 회장, GTC…’서 계속
업계에서는 최 회장의 이번 행보가 HBM을 중심으로 글로벌 AI 생태계 협력을 공고히 하려는 움직임으로 해석하고 있다. SK하이닉스는 삼성전자와 함께 차세대 HBM4 공급 경쟁을 벌이고 있으며, 엔비디아와의 협력은 AI 반도체 생태계에서 중요한 축으로 꼽힌다. 이번 회동은 지난달 미국 실리콘밸리에서 이뤄진 ‘치맥 회동’ 이후 약 한 달 만에 성사된 것이다. 양사는 HBM을 중심으로 AI 반도체 협력 관계를 이어가고 있다. SK하이닉스는 이번 GTC에서 AI 메모리 기술과 제품 라인업을 소개하는 전시 공간을 열었다. 전시관은 ▲엔비디아 협업 존 ▲제품 포트폴리오 존 ▲이벤트 존 등으로 구성됐다. 전시장 입구에 마련된 ‘엔비디아 협업 존’은 SK하이닉스와 엔비디아의 협력

성과를 보여주는 핵심 공간이다. 이곳에서는 HBM4와 HBM3E, 저전력 메모리 모듈 SOCAMM2 등 SK하이닉스의 메모리 제품이 엔비디아 AI 플랫폼에 적용된 사례를 중심으로 GPU 기반 AI 가속기의 메모리 구성을 모형과 실물 형태로 구현해 전시한다. 특히 엔비디아와 협업해 개발한 액체 냉각식 솔리드스테이트드라이브(eSSD)를 비롯해 SK하이닉스의 LPDDR5X가 탑재된 엔비디아 AI 슈퍼컴퓨터 ‘DGX 스파크(DGX Spark)’도 함께 공개됐다. ‘제품 포트폴리오 존’에서는 HBM4와 HBM3E를 비롯해 고용량 서버용 D램 모듈과 LPDDR6, GDDR7, eSSD, 자동차용 메모리 솔루션 등 AI 시대를 겨냥한 메모리 제품 라인업을 선보인다. 참여형 체험 공간인 ‘이벤트 존’에서는 HBM 적용 구조를 모티브로 한 ‘HBM 16단 쌓기 게임’이 운영된다. /구남영 기자



/양성운 기자 ysw@